附件5-1

**2024年“中国芯”关键技术优秀产品（IP）申报表**

**企业信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称****（中英文）** |  |
| **企业简介** |  |
| **企业人员规模** | **2023年** |  | **2024年****（上半年）** |  |
| **公司产品销售主要依靠：****□公司自有销售团队 □委托分销代理商 □其他方式** |
| **联系人姓名** |  | **职务** |  |
| **地址** |  | **邮编** |  |
| **座机电话** |  | **手机** |  |
| **E-mail** |  | **传真** |  |
| **公司产品****按应用领域分类**（细分产品至多选1类） | □IP | □处理器 □存储 □图形 □显示 □其他数字 □射频□接口 □模拟/数模混合 |
| **公司应用市场及销售情况** |  | **销售总额****（单位：万元）** |
| **2023年全年** |  |
| **2024年上半年** |  |
| **2024年全年预计** |  |
| **市场份额**（注：根据市场总量实际估测） |  |
| **公司服务设计企业情况** |  | **服务规上客户数量(客户年销售额>2000万元)** | **服务客户数量** |
| **2023年全年** |  |  |
| **2024年上半年** |  |  |
| **2024年全年预计** |  |  |
| **服务国内设计企业情况介绍** | **1、主要国内设计企业客户****2、合作内容及相应业务量****3、服务措施等方面****（可分年度说明）** |
| **企业规模分类** | □大型 □中型 □小型  |
| **是否为“专精特新”企业** | □是（□国家级 □省级） □否 |
| **融资轮次** |  |
| **外扩需求** | □是 □否 |

**公司产品信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称及****型号** |  |
| **产品服务场景分类** | □消费级 □工业级 □车规级 □其他：  |
| **主要性能和指标** | 注：请提交产品手册等资料 |
| **本产品的创新性及所获得的知识产权形式** | **已受理专利数** |  |
| **已获得专利数** |  |
| 注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料 |
| **本产品的应用市场及销售情况** |  | **销售总额****（单位：万元）** | **销售量****（单位：套）** |
| **自产品推出之时起至今** |  |  |
| **2023年全年** |  |  |
| **2024年上半年** |  |  |
| **2024年全年预计** |  |  |
| **市场份额** | （注：根据市场总量实际估测） |
| **对标国外相关芯片产品的情况** | （注：请列出参选产品与国外同类产品在技术参数、国内外市场占有率方面的具体情况对比，最好能体现国外相关产品的具体型号） |
| **法律声明：** **申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。**法人/授权代表签名：企业（盖章） 日期： |